



#### RE450-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Ungebohrt
- Heißverzinnt (HAL-leadfree) mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für ca. 40 verschiedene QFP-, SOP-, SSOP-, SDIP-Gehäuse:
- QFP 0,80 mm Pitch: 44, 56, 64, 72, 80, 94, 100, 120-Pin
- QFP 0,85 mm Pitch: 48, 54, 56, 64, 68, 80, 100-Pin
- QFP 0,50 mm Pitch: 48, 64, 72, 80, 100, 120, 144, 160-Pin
- SOP 1,27 mm Pitch: max. 44-Pin in 225, 300, 375, 450, 525, 600 mil.
- SOP 1,00 mm Pitch: max. 36-Pin in 225, 300, 375 mil.
- SSOP 0,80 mm Pitch: max. 42-Pin in 300, 450 mil.
- SSOP 0,65 mm Pitch: max. 30-Pin in 225, 300 mil.
- SDIP 1,778 mm Raster: max. 64-Pin in 300, 400, 500, 600, 750 mil.
- Größe 100 x 160 mm